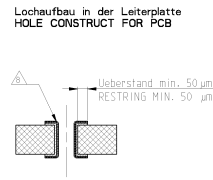
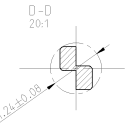
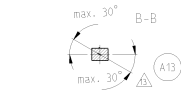
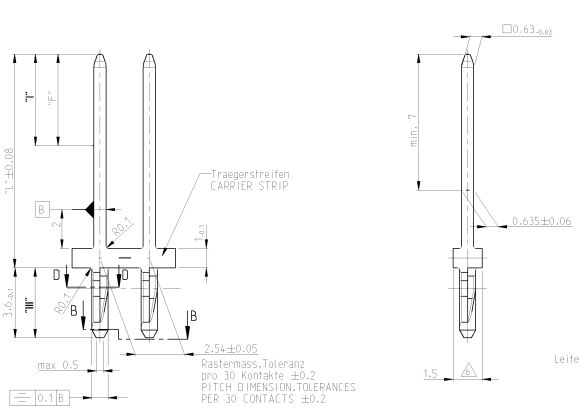


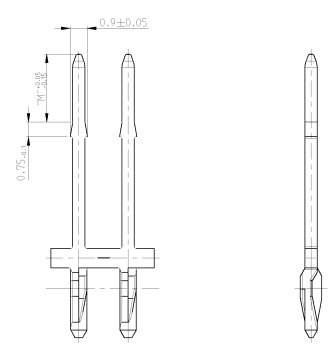
REV.		REVISIONS			
NO.	DATE	BY	CHK.	APP.	REASON
A1	-	TM			REVISION
A10	-	REVIS	PER	ECO-11-05050	
A11	-	REVIS	PER	ECO-11-05064	

### VERSION A



Durchplattierte Bohrung Spezifikation PLATING ACROSS OF HOLE SPEC.			
Lochbauform LP HOLE CONSTRUCT PCB	△	△	△
Kupferschicht COPPER COATING	25-75 µm	25-75 µm	25-50 µm
Zinn/Blei Schicht TIN/LEAD COATING	4-10 µm	-	-
Zinn Schicht TIN COATING	-	-	0.5-1.5 µm
Nickel Schicht NICKEL COATING	-	max. 5 µm	-
Gold Schicht GOLD COATING	-	max. 0.2 µm	-
Bohr Ø HOLE DIA.	1.15±0.025	1.15±0.025	1.15±0.025
Plattierter Ø PLATED DIA.	0.94+0.15	0.94+0.15	1.07+0.045 -0.055

### VERSION B



- Bemerkungen**  
**NOTES**
- 1. Massgebend ist der deutsche Text ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
  - 2. Verwendung fuer Leiterplattendicke: 1.6 ±0.14mm USED ON PCB THICKNESS: 1.6 ±0.14mm
  - 3. -
  - 4. Loetbarkeit nach DIN 40046 SOLDERABILITY ACCORDING TO DIN 40046
  - 5. Kontaktstift siehe Zeichnung, TE 111-18063, Version B CONTACT PIN SEE DRAWING TE 111-18063, VERSION B
  - 6. Zustand vor dem Einpressen STATUS BEFORE INSERTION
  - 7. Zulassige Saebelfoemigkeit: 40mm/m PERMITTED SABERSHARPNESS: 40mm/m
  - 8. Einpresszone fuer 1.6mm Leiterplatte Anforderung an Leiterplattenloch, siehe Tabelle PRESS-IN AREA FOR 1.6mm PCB REQUIREMENTS ON PCB HOLE, SEE TABLE
  - 9. Verpackungseinheit: 50.000 Stck. auf wiederverwendbarer Kunststoff-Spule Ø 588mm mit Zwischlagenpapier, 3 Spulen im Karton PACKAGING UNIT: 50.000 Pcs ON REUSABLE PLASTIC REEL DIA. 588MM WITH INTERLAYING PAPER, 3 REELS IN BOX
  - 10. Lochbauform (Zinn/Blei) in der Leiterplatte (siehe Tabelle) HOLE CONSTRUCT (TIN/LEAD) FOR PCB (SEE TABLE)
  - 11. Lochbauform (Nickel/Gold) in der Leiterplatte (siehe Tabelle) HOLE CONSTRUCT (NICKEL/GOLD) FOR PCB (SEE TABLE)
  - 12. Lochbauform (Zinn) in der Leiterplatte (siehe Tabelle) HOLE CONSTRUCT (TIN) FOR PCB (SEE TABLE)
  - 13. Verdringung Action Pin, Spitze max. 30° Distription of Action Pin, tip max. 30°

VERSION	TE CONNECTIVITY REFERENCE NUMBER	REV.	MATERIAL	UPPER SURFACE	LOWER SURFACE	PLATING	FINISH	REF. DESIG.	REF. DIM.	REF. UNIT	
A	2-963964-6	A		Zinn/TIN				7	9.2	-	12.8
	3-963964-7	A		Gold/GOLD				5.5	11.1	-	14.7
	2-963964-7	A		Zinn/TIN				7	11.1	-	14.7
	2-963964-6	B		Zinn/TIN				7	13.6	7.75	17.2
B	2-963964-5	C	Cu/NiSi P50	Zinn/TIN		S	0.05	8.2	17.8	9.25	21.4
	2-963964-4	A		Zinn/TIN				7	13.6	7.75	17.2
	2-963964-4	B		Zinn/TIN				7	9.8	-	13.4
	2-963964-4	A		Gold/GOLD				5.5	9.8	-	13.4
	2-963964-4	B		Zinn/TIN				7	9.8	-	13.4
	1-963964-4	B		Gold/GOLD				5.5	9.8	-	13.4
	2-963964-3	B		Zinn/TIN				7	8.05	-	11.65
	1-963964-3	B		Gold/GOLD				5.5	8.05	-	11.65

Oberflaeche/SURFACE	
<b>Zone "I" AREA</b>	Goldausfuehrung: 0.8 µm bis 2 µm Au ueber Ni GOLD VERSION: 0.8 µm TO 2 µm Au OVER Ni Zinn-Ausfuehrung: 1 µm bis 3 µm Sn TIN-VERSION: 1 µm TO 3 µm Sn
<b>Zone "II" AREA</b>	Schichtdicke: 1.3 µm bis 2.2 µm Ni COAT THICKNESS: 1.3 µm TO 2.2 µm Ni
<b>Zone "III" AREA</b>	Schichtdicke: 0.8 µm bis 1.8 µm Sn ueber Ni COAT THICKNESS: 0.8 µm TO 1.8 µm Sn OVER Ni

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT		REV. NO.	00022002	TE Connectivity	
DATE	15.05.2011	REV. DATE	00022002	ACTION PIN FOR 1.6mm HOLE	
DESIGNER	TM	DATE	15.05.2011	ACTION PIN fuer 1.6mm Loch, nicht leitend	
APP. NO.	00022002	REV. NO.	00022002	REV. DATE	
REV. DATE	15.05.2011	REV. DATE	15.05.2011	REV. DATE	
REV. DATE	15.05.2011	REV. DATE	15.05.2011	REV. DATE	
REV. DATE	15.05.2011	REV. DATE	15.05.2011	REV. DATE	